

# 钢泰公司全线产品满足 SiP 封装焊接的方方面面

## 热管理

- TIM2 / Heat-Spring®
- TIM1
  - 含（助焊剂）镀层的预成型焊片
  - 焊料 TIM
  - 液态金属焊锡膏
  - 液态金属



## 微型无源元件

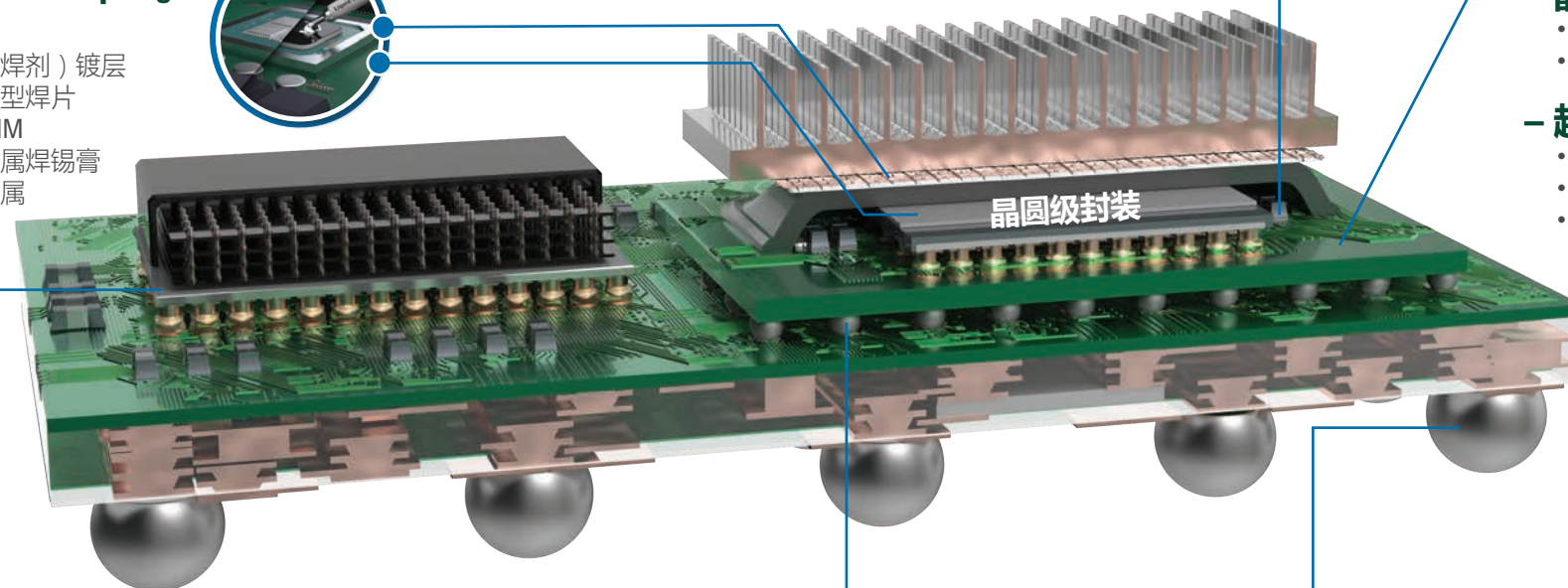
## 系统级封装

### - 晶圆级植球助焊剂

- 水溶性
- 无卤素

### - 超细间距焊锡膏

- 水溶性、超低残留、免洗
- 无卤素
- 6, 7, 8 号粉



## 3D逻辑 / 记忆封装和倒装焊

### - 晶圆凸块助焊剂

- 水溶性
- 旋转涂胶和喷涂
- 无卤素

### - 倒装芯片助焊剂

- 水溶性、超低残留、免洗
- 浸蘸、喷雾、喷涂
- 可无卤或含卤

## 植球

### - 植球助焊剂

- 可提供水溶性和免洗型产品
- 针转移和印刷
- 可无卤或含卤

## SMT

- 焊锡膏
- 焊锡线
- 助焊剂
- 焊片
- 焊锡块

今天联系我们的工程师：[china@indium.cn](mailto:china@indium.cn)

有关详情，请浏览：[www.indium.com/HIA](http://www.indium.com/HIA)

From One Engineer To Another®

©2024 钢泰公司

编号：99292 (SC A4) R9



# 半导体助焊剂和焊锡膏推荐产品



产品类别	产品类型	产品型号	助焊剂类型	无卤素	应用	注释
助焊剂	Wafer Bumping 助焊剂	SC-5R	溶剂清洗	是	旋涂	适用于高铅、锡铅共晶和锡银凸块
		WS-3543	水洗型	是	旋涂	高黏度, 适用于高铜柱和大凸块 (>40 微米)
		WS-3401	水洗型	是	旋涂	低黏度, 适用于小铜柱和小凸块
	晶圆级或基板级封装助焊剂	WS-676	水洗型	是	印刷	适用于0.5mm及更细间距的晶圆级和基板级封装
		WS-759				
		WS-829				
	倒装芯片助焊剂	WS-575-SP	水洗型	是	喷涂/点胶	适用于锡铅共晶和锡银焊接到SOP的逻辑倒装芯片应用
		FC-NC-HT-A1	免洗型	是	喷涂/点胶	适用于大规模回流应用, 与CUF兼容
		WS-446	水洗型	否	浸蘸	针对可焊性低的应用的最佳助焊剂
		WS-688	水洗型	是	浸蘸	普遍适用于多核逻辑倒装芯片应用
		WS-641	水洗型	是	浸蘸	为chip-on-wafer以及高密度铜柱应用设计
		NC-26-A	超低残留, 免洗	是	浸蘸	与底部填充剂CUF/MUF的兼容性最高
		NC-26S	超低残留, 免洗	是	浸蘸	可避免细间距应用中的到芯片的毛细作用
	植球助焊剂	NC-699	近零残留	是	浸蘸	可焊性佳, 与多种CUF/MUF兼容
		WS-446-AL	水洗型	否	针转移	针对可焊性低的应用的最佳助焊剂
		WS-823	水洗型	是	针转移	全方面最优的无卤倒装芯片助焊剂, 清洗简单
		WS-829	水洗型	是	印刷和针转移	适用于球径 <0.25mm 和细间距高密度的植球应用; 清洗性能最佳
	倒装芯片助焊剂和植球助焊剂	NC-585	免洗型	符合规定	针转移	裸镍表面上润湿性能出色, 适用于间距低于0.5mm的BGA/PGA应用
NC-809		超低残留, 免洗	是	浸蘸 印刷和针转移	润湿性能更好, 与多种CUF/MUF兼容 适用于免洗工艺, 金表面上润湿良好	
WS-446HF		水洗型	是	浸蘸 针转移	全方面最优的无卤倒装芯片助焊剂, 清洗简单 适用于球径不小于0.25mm 的一步 Cu OSP 应用	
焊锡膏	喷射点胶和精细点胶焊锡膏	PicoShot® WS-5M	水洗型	是	喷涂	适用于喷射点胶沉积直径不小于 300µm的应用, 以及金属盖封细线点胶应用
		PicoShot® NC-5M	溶剂清洗、水基清洗剂或者免洗	是	喷涂	适用于喷射点胶沉积直径不小于 300µm的应用, 以及金属盖封细线点胶应用
		Indium12.8HF			喷射和微点胶	适用于喷射点胶沉积直径大于 80µm的应用, 以及金属盖封细线点胶应用
	系统级封装 (SiP) 焊锡膏	SiPaste® 3.2HF	水洗型	是	印刷	适合超细间距印刷的T6, 7, 8 焊锡膏
		SiPaste® C201HF	去离子水+皂化剂或者半水清洗剂			
		SiPaste® 10.8HF	溶剂或皂化剂清洗, 或者免洗			
SiPaste® SMQ77		免洗型				
其他	免洗粘合剂	NC-702	几乎无残留	是	浸蘸/点胶/喷射点胶	粘住裸片、芯片和焊片, 适用于甲酸回流应用